

# UEFI 設定公用程式

## 1 簡介

本章節說明使用 UEFI 設定公用程式設定您系統的方式。您可在開啟電腦電源後立即按下 <F2> 或 <Del> 執行 UEFI 設定公用程式，否則開機自我測試 (POST) 將繼續原本的測試常式。若您想要在 POST 後進入 UEFI 設定公用程式，請按下 <Ctl> + <Alt> + <Delete>，或按下系統機殼上的重設按鈕重新啟動系統。您也可先關閉系統電源，再重新開啟而重新啟動。



因為 UEFI 軟體會持續更新，所以下列 UEFI 設定畫面及說明僅供參考，可能會與您在畫面上看到的不完全相同。

### 1.1 UEFI 功能表列

在畫面最上方的功能表列共有下列選項：

<b>主要</b>	適用於設定系統時間／日期資訊
<b>OC Tweaker</b>	適用於超頻設定
<b>進階</b>	適用於進階系統設定
<b>工具</b>	實用工具
<b>硬體監視器</b>	顯示目前的硬體狀態
<b>開機</b>	適用於設定開機設定及開機優先順序
<b>安全性</b>	適用於安全性設定
<b>結束</b>	結束目前畫面或 UEFI 設定公用程式

## 1.2 導覽鍵

使用 <←> 鍵或 <→> 鍵選擇功能表列上的選項，再使用 <↑> 鍵或 <↓> 鍵上下移動游標選擇項目，然後按下 <Enter> 進入子畫面。您也可以使用滑鼠點選您所需的項目。

請核對下表，確認各導覽鍵的說明。

導覽鍵	說明
+ / -	變更選取項目的選項
<Tab>	切換至下一個功能
<PGUP>	前往上一頁
<PGDN>	前往下一頁
<HOME>	前往畫面最上方
<END>	前往畫面最下方
<F1>	顯示一般說明畫面
<F7>	捨棄變更並結束設定公用程式
<F9>	在所有設定中，載入最佳預設設定值
<F10>	儲存變更並結束設定公用程式
<F12>	列印畫面
<ESC>	跳至結束畫面或結束目前的畫面

## 2 主畫面

當您進入 UEFI 設定公用程式時，主畫面將出現並顯示系統一覽。



### 進入使用中頁面

進入 UEFI 設定公用程式時，選擇預設頁面。

### Full HD UEFI

選取 [Auto] (自動) 時，若螢幕支援 Full HD 解析度，解析度將設為 1920 x 1080。若螢幕不支援 Full HD 解析度，則將設為 1024 x 768。選取 [Disabled] (關閉) 時，解析度將直接設為 1024 x 768。

### 3 OC Tweaker 畫面

在 OC Tweaker 畫面中，您可設定超頻功能。



因為 UEFI 軟體會持續更新，所以下列 UEFI 設定畫面及說明僅供參考，可能會與您在畫面上看到的不完全相同。

#### 載入最佳化 CPU OC 設定

您可以使用此選項載入最佳化的 CPU 超頻設置。請注意，超頻可能會造成 CPU 及主機板損壞。您應自行負擔超頻風險及成本。

#### CPU 設定

##### CPU 倍頻

CPU 速度是由 CPU 倍頻乘以 BCLK 決定。增加 CPU 倍頻將增加內部 CPU 時脈速度，但不會影響其他元件的時脈速度。

##### CPU 快取率

CPU 內部匯流排速率。最大值應與 CPU 倍頻相同。

##### 最小 CPU 快取比

設定最小 CPU 內部匯流排速度比。

## BCLK 頻率

CPU 速度是由 CPU 倍頻乘以 BCLK 決定。增加 BCLK 將增加內部 CPU 時脈速度，但也將影響其他元件的時脈速度。

## BCLK/PCIE 倍頻

設定 BCLK 倍頻，防止 PC 因內部 CPU 時脈速度與其他元件的時脈速度過高時而當機。

## 展頻

啟用 Spread Spectrum (展頻) 可減少電磁干擾並通過 EMI 測試。停用可在超頻時達到更高的時脈速度。

## Intel SpeedStep Technology

Intel SpeedStep 技術允許處理器在多項頻率及電壓點之間切換，以獲得最佳省電及散熱效率。

## Intel 渦輪加速模式 (Turbo Boost) 技術

操作系統要求最高效能狀態時，Intel 渦輪加速模式 (Turbo Boost) 技術可讓處理器以基本頻率以上執行。

## 過濾 PLL 頻率

CPU BCLK 過濾頻率。選擇 1.6 作為較佳的超頻功能。

## 長時間功耗限制

以瓦特為單位設定封裝功耗限制 1。超出限制時，CPU 倍頻在經過一段時間後將變低。下限可保護 CPU 並節省功率，而上限則可改善效能。

## 長時間持續時間

設定超出長時間功耗限制時，直到 CPU 倍頻變低的時間長度。

## 短時間功耗限制

以瓦特為單位設定封裝功耗限制 2。超出限制時，CPU 倍頻將立即變低。下限可保護 CPU 並節省功率，而上限則可改善效能。

## 第一平台電流限制

設定在 Turbo 模式下的 CPU 電流限制，以安培為單位。下限可保護 CPU 並節省功率，而上限則可改善效能。

## DRAM 時脈設定

### DRAM 參考時脈

選擇自動，自動取得最佳設定。

### DRAM 頻率

若選擇 [Auto] (自動)，主機板將偵測記憶體模組是否插入，並自動指派適合的頻率。

## DRAM 設定



## DRAM Tweaker

在核取方塊中勾選，微調 DRAM 設定。按一下 [OK] (確定) 確認並套用新設定。

## 記憶體省電模式

設定 CKE 與相關記憶體省電功能。

## CAS# 延遲 (tCL)

傳送行位址至記憶體與資料開始回應之間的時間。

## RAS# 至 CAS# 延遲 (tRCD)

在開啟記憶體列及存取記憶體行之間所需的時脈週期數。

### 列預充電延遲 (tRP)

在發佈預充電命令及下一列開啟之間所需的時脈週期。

### RAS# 啟用時間 (tRAS)

在 bank active 命令與發佈預充電命令之間所需的時脈週期。

### 命令速率 (CR)

在選取記憶體晶片時以及可發佈首次啟動命令時之間的延遲。

### 寫入恢復時間 (tWR)

在可預充電 active bank 之前，完成有效寫入作業後必須經過的延遲時間。

### 重新整理循環時間 (tRFC)

從 Refresh (重新整理) 命令直到發佈第一個 Activate (啟動) 命令至相同次序的時脈數。

### RAS 至 RAS 延遲 (tRRD)

在相同次序不同組別中啟動的兩列間時脈數。

### RAS 至 RAS 延遲 (tRRD\_L)

在相同次序不同組別中啟動的兩列間時脈數。

### 寫入到讀取延遲 (tWTR)

在相同內部組別中的上次有效寫入作業及下次讀取命令之間的時脈數。

### 寫入到讀取延遲 (tWTR\_L)

在相同內部組別中的上次有效寫入作業及下次讀取命令之間的時脈數。

### 讀取到預充電 (tRTP)

在相同次序中，於讀取命令至列預充電命令之間插入的時脈數。

### 四啟動視窗 (tFAW)

在相同次序中允許的四個啟動時間視窗。

### CAS 寫入延遲 (tCWL)

設定 CAS 寫入延遲。

### tREFI

以平均週期間隔設定重新整理週期。

**tCKE**

設定 DDR4 一進入自我重新整理模式後，在內部啟動最少單一重新整理命令的時間長度。

**tCCCD**

設定相同 Rank 分隔參數的 back to back CAS to CAS (亦即 READ to RAED 或 WRITE to WRITE)。

**tCCCD\_L**

設定相同 Rank 分隔參數的 back to back CAS to CAS (亦即 READ to RAED 或 WRITE to WRITE)。

**tCCCD\_WR\_L**

設定相同 Rank 分隔參數的 back to back CAS to CAS (亦即 READ to RAED 或 WRITE to WRITE)。

**tRWSR**

設定相同 Rank 分隔參數的 READ to WRITE 相同 Rank 未啟動週期 Back to back READ to WRITE。

**tRWDD**

設定不同 DIMM 分隔參數的 Read to Write 不同 DIMM 未啟動週期 Back to back READ to WRITE。

**tRWDR**

設定不同 Rank 分隔參數的 Read to Write 不同 Rank 未啟動週期 Back to back READ to WRITE。

**tWRDD**

設定不同 DIMM 分隔參數的 Write to Read 不同 DIMM 未啟動週期 Back to back READ to WRITE。

**tWRDR**

設定不同 Rank 分隔參數的 Write to Read 不同 Rank 未啟動週期 Back to back READ to WRITE。

**tWWDD**

設定不同 DIMM 分隔參數的 Write to Write 不同 DIMM 未啟動週期 Back to back READ to WRITE。



**tWWDR**

設定不同 Rank 分隔參數的 Write to Write 不同 Rank 未啟動週期 Back to back READ to WRITE。

**tRRDD**

設定不同 DIMM 分隔參數的 Read to Read 不同 DIMM 未啟動週期 Back to back READ to WRITE。

**tRRDR**

設定不同 Rank 分隔參數的 Read to Read 不同 Rank 未啟動週期 Back to back READ to WRITE。

**ODT WR (CH A)**

設定通道 A 記憶體終端電阻的 WR。

**ODT PARK (CH A)**

設定通道 A 記憶體終端電阻的 PARK。

**ODT NOM (CH A)**

使用此參數可變更 ODT (CH A) 自動/手動設定。

**ODT WR (CH B)**

設定通道 B 記憶體終端電阻的 WR。

**ODT PARK (CH B)**

設定通道 B 記憶體終端電阻的 PARK。

**ODT NOM (CH B)**

使用此參數可變更 ODT (CH B) 自動/手動設定。

**ODT WR (CH C)**

設定通道 C 記憶體終端電阻的 WR。

**ODT PARK (CH C)**

設定通道 C 記憶體終端電阻的 PARK。

**ODT NOM (CH C)**

使用此參數可變更 ODT (CH C) 自動/手動設定。

**ODT WR (CH D)**

設定通道 D 記憶體終端電阻的 WR。

## ODT PARK (CH D)

設定通道 D 記憶體終端電阻的 PARK。

## ODT NOM (CH D)

使用此參數可變更 ODT (CH D) 自動/手動設定。

## FIVR 設定

### CPU Vcore 電壓模式

自動：自動取得最佳設定。

覆寫：電壓為固定。

### Vcore 電壓其他偏移

設定加入 Vcore 的動態 Vcore 電壓。

### CPU 快取

自動：自動取得最佳設定。

彈性：系統為重度負載時，將在 CPU 上增加電壓。

覆寫：電壓為固定。

### CPU 快取電壓偏移

設定 CPU 快取的電壓。設定電壓偏高可增加超頻時系統的穩定性。

### 系統代理程式電壓偏移

設定系統代理程式的電壓。設定電壓偏高可增加超頻時系統的穩定性。

### CPU 整合式 VR 故障

停用 FIVR 故障會提高閾值觸發 CPU 過電流防護及過電壓防護，並獲得最佳的超頻功能。

### CPU 整合式 VR 效率模式

啟用 FIVR Efficiency Management (FIVR 效率管理) 維持省電。停用此項目可獲得更佳的效能及超頻功能。

## 電壓設定

### CPU 輸入電壓

設定 CPU 的電壓。

## CPU 防掉壓功能開關

CPU Load-Line Calibration (CPU 防掉壓功能開關) 可協助防止 CPU 電壓在系統處於重度負載時驟降。

## DRAM 電壓

使用此參數可設定 DRAM 電壓。

## DRAM 啟動電源供應

設定 DRAM 啟動電源供應的電壓。

## PCH PLL 電壓

設定晶片組 1.5V 電壓。使用預設設定，以獲得最佳效能。

## CPU I/O 電壓

設定 CPU IO 電壓供應單元的電壓。

## ME 電壓

設定 ME 電壓。

## PCH 電壓

設定 PCH 電壓。

## 4 進階畫面

在此章節中，您可以設定下列項目：CPU 設定、晶片組設定、儲存裝置設定、Super IO 設定、ACPI 設定、USB 設定及可信賴運算。



在此部分中，設定錯誤數值會造成系統故障。

## 4.1 CPU 設定



### Intel 超執行緒技術

Intel 超執行緒技術允許多個執行緒在各核心上執行，因此可改善整體執行緒軟體的效能。

### 現用處理器核心

選擇要在各處理器封裝中啟用的核心數。

### 不執行記憶體保護

採用不執行記憶體保護技術的處理器，可防止特定級別的惡意緩衝區溢位攻擊。

### 硬體預擷取

自動預擷取處理器的資料及代碼。啟用可獲得更佳效能。

### 鄰近快取線預擷取

擷取目前要求的快取線時，自動預擷取後續快取線。啟用可獲得更佳效能。

### Intel 虛擬化技術

Intel 虛擬化技術允許平台在獨立磁碟分割中執行多個作業系統及應用程式，使單一電腦系統可像多部虛擬系統一樣使用。

### CPU 溫度控制

啟用 CPU 內部溫度控制機制，防止 CPU 過熱。

### CPU C 狀態支援

啟用 CPU C States Support (CPU C 狀態支援) 維持省電。建議維持啟用 C3、C6 及 C7，獲得最佳的省電效率。

### 封裝 C 狀態支援

啟用 CPU、PCIe、記憶體、顯示卡 C 狀態支援維持省電。

### CPU C3 狀態支援

啟用 C3 睡眠狀態降低耗電量。

### CPU C6 狀態支援

啟用 C6 深度睡眠狀態降低耗電量。

### 增強暫停時態 (C1E)

啟用 Enhanced Halt State (C1E) (增強暫停時態 (C1E)) 降低耗電量。

## 4.2 晶片組設定



### Intel Thunderbolt™ 技術

啟用或停用 Intel® Thunderbolt™ 功能。

### VT-d

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O 可協助您的虛擬電腦監視器改善應用程式相容性及可靠性，提升硬體的使用效率，並提供進一步的管理能力、安全性、隔離及 I/O 效能。

### PCIe1 連接速度

選擇 PCIe1 的連結速度。

### PCIe2 連接速度

選擇 PCIe2 的連結速度。

### PCIe3 連接速度

選擇 PCIe3 的連結速度。

### PCIe4 連接速度

選擇 PCIe4 的連結速度。

### PCIe5 連接速度

選擇 PCIe5 的連結速度。

## PCIe6 連接速度

選擇 PCIe6 的連結速度。

## 內建網路卡 1

啟用或停用內建網路介面控制器。

## 內建網路卡 2

啟用或停用內建網路介面控制器。

## 內建 HD 音訊

啟用／停用內建 HD 音訊。設為「Auto (自動)」即可啟用內建 HD 音訊，而安裝音效卡後將自動停用。

## 前置面板

啟用／停用前置面板 HD 音訊。

## 深層睡眠

設定深層睡眠模式，在電腦關閉時節省電源。

## 還原 AC/ 功率損耗

選擇停電後的電源狀態。若選擇 [Power Off (關閉電源)]，電源將在恢復電力後維持關閉。若選擇 [Power On (開啟電源)]，系統將在恢復電力時開始開機。

## 晚安 LED

啟用 Good Night LED (晚安 LED) 後，電源／HDD LED 將在系統開啟時關閉。系統進入待機／休眠模式時，也會自動關閉電源及鍵盤 LED。

## 板載偵錯連接埠 LED

啟用 / 停用板載 Dr. Debug LED。



### 4.3 儲存設定



#### 硬碟 S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T 代表自我監控、分析及報告技術。這是一套供電腦硬碟機偵測及報告各種可靠性指標的監控系統。

## 4.4 Super IO 設定



### 序列連接埠 1

啟用或停用序列連接埠 1。

### 序列連接埠 1 位址

選擇序列連接埠 1 的位址。

### 序列連接埠 2

啟用或停用序列連接埠 2。

### 序列連接埠 2 位址

選擇序列連接埠 2 的位址。

### PS2 Y-Cable

啟用 PS2 Y Cable 或將此選項設置為 Auto (自動)。

## 4.5 ACPI 設定



### 載入到 RAM

選擇停用 ACPI 載入類型 S1。建議選擇自動，節省 ACPI S3 的電力。

### PS/2 鍵盤電源開啟

允許由 PS/2 鍵盤喚醒系統。

### 來電鈴聲開機

允許由板載 COM 連接埠數據機的來電鈴聲訊號喚醒系統。

### 定時開機

允許由真實時間鬧鈴喚醒系統。設為「By OS」即可由您的作業系統操控。

### USB 鍵盤／遙控開機

允許由 USB 鍵盤或遙控器喚醒系統。

### USB 滑鼠開機

允許由 USB 滑鼠喚醒系統。

### PCIE 裝置電源開啟

允許由 PCIE 裝置喚醒系統及啟用網路喚醒。

## 4.6 USB 設定



### USB 控制器

啟用或停用所有 USB 2.0 連接埠。

### Intel USB 3.0 模式

選取 Intel® USB 3.0 控制器模式。設為 [Smart Auto] 可在重新開機後持續啟用 USB 3.0 驅動程式 (USB 3.0 於 BIOS 中啟用)。設為 [Auto] 可在進入作業系統後自動啟用 USB 3.0 驅動程式 (USB 3.0 於 BIOS 中停用)。設為 [Enabled] 可持續啟用 3.0 驅動程式 (必須安裝驅動程式, 以在 Windows® 7 下使用 USB 裝置)。設為 [Disabled] 可停用 USB 3.0 連接埠。

### 舊型 USB 支援

啟用或停用 USB 2.0 裝置的舊型作業系統支援。若您有 USB 相容性問題, 建議停用舊型 USB 支援。請僅在 UEFI 設定及 Windows/Linux 作業系統下, 選擇 UEFI 設定以支援 USB 裝置。

### 舊型 USB 3.0 支援

啟用或停用 USB 3.0 裝置的舊型作業系統支援。若您有 USB 相容性問題, 建議停用舊型 USB 支援。請僅在 UEFI 設定及 Windows/Linux 作業系統下, 選擇 UEFI 設定以支援 USB 裝置。

## 4.7 可信賴運算



### 安全性裝置支援

啟用即可為您的硬碟機啟動信賴平台模組 (TPM) 安全防護。

## 5 工具



### System Browser

華擎系統瀏覽器會顯示您目前電腦及連接裝置的一覽。

### OMG (Online Management Guard)

管理員可透過 OMG 建立網際網路宵禁或限制特定時間的網際網路存取。您可安排開放其他使用者存取網際網路的開始及結束時間。為防止使用者略過 OMG，必須建立沒有修改系統時間權限的訪客帳戶。

### 除濕機功能

若啟用 Dehumidifier Function (除濕機功能)，電腦將在進入 S4/S5 狀態後自動開機為系統除濕。

### 除濕時段

設定電腦開機並進入 S4/S5 狀態後啟用 Dehumidifier (除濕機) 的時段。

### 除濕機時間長度

設定電腦返回 S4/S5 狀態之前的除濕程序時間長度。

### 除濕機 CPU 風扇設定

設定啟用 Dehumidifier (除濕機) 時的 CPU 風扇速度。數值越高，風扇速度越快。

最大值：255

最小值：1

## 硬碟守護神

用我們特殊設計的電源線將硬碟接至板載 SATA 電源接頭後，即可視需要開啟與關閉硬碟。此設計可讓您保護隱私、節省更多能源，以及延長硬碟的使用壽命。



## 華擎硬碟守護神

設為 [Enabled] 可開啟華擎硬碟守護神。設為 [Disabled] 可關閉華擎硬碟守護神。建議啟用 AHCI 模式，以完全支援華擎硬碟守護神。您也可透過作業系統下的華擎硬碟守護神應用程式啟用／停用華擎硬碟守護神。

## 板載 SATA 電源開關 (SATA\_PWR\_1)

設為 [Power On] 可開啟板載 SATA 電源接頭。設為 [Power Off] 可關閉板載 SATA 電源接頭。

## 重新偵測 SATA 電源連接

重新偵測您的 SATA 電源連接。對硬碟組態進行任何變更後，建議您繼續進行重新偵測。您也可透過作業系統下的華擎硬碟守護神應用程式繼續重新偵測。

## Easy RAID Installer

簡易 RAID 安裝程式可協助您從支援光碟中複製 RAID 驅動程式至 USB 儲存裝置。複製驅動程式後，請變更 SATA 模式為 RAID，然後即可開始在 RAID 模式中安裝作業系統。

## Easy Driver Installer

簡易驅動安裝程式為 UEFI 內便利的工具，會以 USB 儲存裝置將 LAN 驅動程式安裝於系統，然後自動下載及安裝其他所需的驅動程式，因此適用於無光碟機可從支援光碟安裝驅動程式的使用者之用。

## UEFI Tech Service

若您的電腦有問題，請聯絡華擎技術服務。在使用 UEFI 技術服務之前，請設定網路組態。

## Instant Flash

將 UEFI 檔案儲存在 USB 儲存裝置中，然後執行 Instant Flash 更新您的 UEFI。

## Internet Flash

華擎 Internet Flash 會從伺服器下載及更新最新的 UEFI 韌體版本。在使用 Internet Flash 之前，請設定網路組態。

\* 如需 BIOS 備份及復原，建議在使用此功能前插入您的 USB 隨身碟。

## Secure Backup UEFI

每當 ROM 映像損毀或過時，請切換至其他快閃 ROM 並執行安全備份 UEFI，以將目前運作正常的 ROM 映像複製至次要快閃 ROM。



## 網路設定

設定 Internet Flash 的網際網路連線設定。



### 網際網路設定

啟用或停用設定公用程式中的音效。

### UEFI 下載伺服器

選擇下載 UEFI 韌體的伺服器。

### 儲存使用者預設值

鍵入設定檔名稱，然後按 **Enter** 將您的設定儲存為使用者預設值。

### 載入使用者預設值

載入先前儲存的使用者預設值。

## 6 硬體狀態監控畫面

本章節提供您監控系統硬體狀態的資訊，其中包括 CPU 溫度、主機板溫度、風扇速度及電壓參數。



### CPU 風扇 1 & 2 設定

選擇適用 CPU 風扇 1&2 的風扇模式，或選擇 Customize (自訂) 設定 5 CPU 溫度，並為各溫度指定個別風扇速度。

### 機殼風扇 1 設定

選擇適用機殼風扇 1 的風扇模式，或選擇 Customize (自訂) 設定 5 CPU 溫度，並為各溫度指定個別風扇速度。

### 機殼風扇 1 溫度來源

選擇適用機殼風扇 1 的溫度來源。

### 機殼風扇 2 設定

選擇適用機殼風扇 2 的風扇模式，或選擇 Customize (自訂) 設定 5 CPU 溫度，並為各溫度指定個別風扇速度。

### 機殼風扇 2 溫度來源

選擇適用機殼風扇 2 的溫度來源。

### 機殼風扇 3 設定

選擇適用機殼風扇 3 的風扇模式，或選擇 Customize (自訂) 設定 5 CPU 溫度，並為各溫度指定個別風扇速度。

### 機殼風扇 3 溫度來源

選擇適用機殼風扇 3 的溫度來源。

### 溫度過熱保護

啟用 Over Temperature Protection (溫度過熱保護) 後, 系統會自動在主機板過熱時關機。

## 7 安全畫面

在本章節中，您可設定或變更系統的監督員／使用者密碼。您也可清除使用者密碼。



### 管理員密碼

設定或變更管理員帳戶密碼。只有管理員有權變更 UEFI 設定公用程式中的設定。在此項目中留白並按下 **Enter** 即可移除密碼。

### 使用者密碼

設定或變更使用者帳戶密碼。使用者無法在 UEFI 設定公用程式中變更設定。在此項目中留白並按下 **Enter** 即可移除密碼。

### 安全開機

啟用以支援 Windows 8.1/8 安全開機。

## 8 開機畫面

本章節顯示系統上供您設定開機設定與開機優先順序的可用裝置。



### Fast Boot

快速開機可將電腦的開機時間降至最短。在快速模式中，您無法從 USB 儲存裝置開機。僅 Windows 8.1/8 支援 Ultra Fast(超快速)模式，且若您使用外部顯示卡，VBIOS 必須支援 UEFI GOP。請注意，由於 Ultra Fast(超快速)模式的開機速度極快，所以進入本 UEFI 設定公用程式的唯一方式為清除 CMOS 或在 Windows 中執行 UEFI 公用程式重新啟動。

### 從內建 LAN 開機

允許由內建 LAN 喚醒系統。

### 設定提示逾時

設定等待設定熱鍵的秒數。

### 開機後的數字鎖定鍵狀態

選擇系統開機時，Num Lock 是否應開啟或關閉。

### 開機嗶聲

選擇系統開機時，開機嗶聲是否應開啟或關閉。請注意，需配備蜂鳴器。

## 全螢幕標誌

啟用可顯示開機標誌，或者停用可顯示正常 POST 訊息。

## 附件軟體顯示

若已啟用 Full Screen Logo (全螢幕標誌)，啟用 AddOn ROM Display (附件軟體顯示) 可查看 AddOn ROM 訊息或設定 AddOn ROM。停用快速開機速度。

## 開機失敗恢復

若電腦多次無法開機，系統將自動還原回預設值。

## 開機失敗恢復計數

設定嘗試開機，直到系統自動還原預設設定值的次數。

## CSM (相容性支援模組)



### CSM

啟用可啟動相容性支援模組。除非您正在執行 WHCK 測試，否則請勿停用。若您使用 Windows 8.1/8 64 位元且所有裝置都支援 UEFI，您也可停用 CSM 以獲得更快的開機速度。

### 啟動 PXE OpROM 原則

僅選擇 UEFI，執行僅支援 UEFI 選項的 ROM。僅選擇 Legacy (舊型)，執行僅支援舊型選項的 ROM。

### 啟動儲存 OpROM 原則

僅選擇 UEFI，執行僅支援 UEFI 選項的 ROM。僅選擇 Legacy (舊型)，執行僅支援舊型選項的 ROM。

### 啟動視訊 OpROM 原則

僅選擇 UEFI，執行僅支援 UEFI 選項的 ROM。僅選擇 Legacy (舊型)，執行僅支援舊型選項的 ROM。

## 9 結束畫面



### 儲存變更並結束

當您選擇此選項後，將彈出下列訊息：「是否儲存設定變更並結束設定？」選擇 [OK] (確定) 儲存變更並結束 UEFI 設定公用程式。

### 捨棄變更並結束

當您選擇此選項後，將彈出下列訊息：「是否捨棄變更並結束設定？」選擇 [OK] (確定) 結束 UEFI 設定公用程式，且不儲存任何變更。

### 捨棄變更

當您選擇此選項後，將彈出下列訊息：「是否捨棄變更？」選擇 [OK] (確定) 捨棄所有變更。

### 載入 UEFI 預設值

為所有選項載入 UEFI 預設值。此操作可使用 F9 鍵。

### 在檔案系統裝置中啟動 EFI Shell

將 shellx64.efi 複製到根目錄中，啟動 EFI Shell。